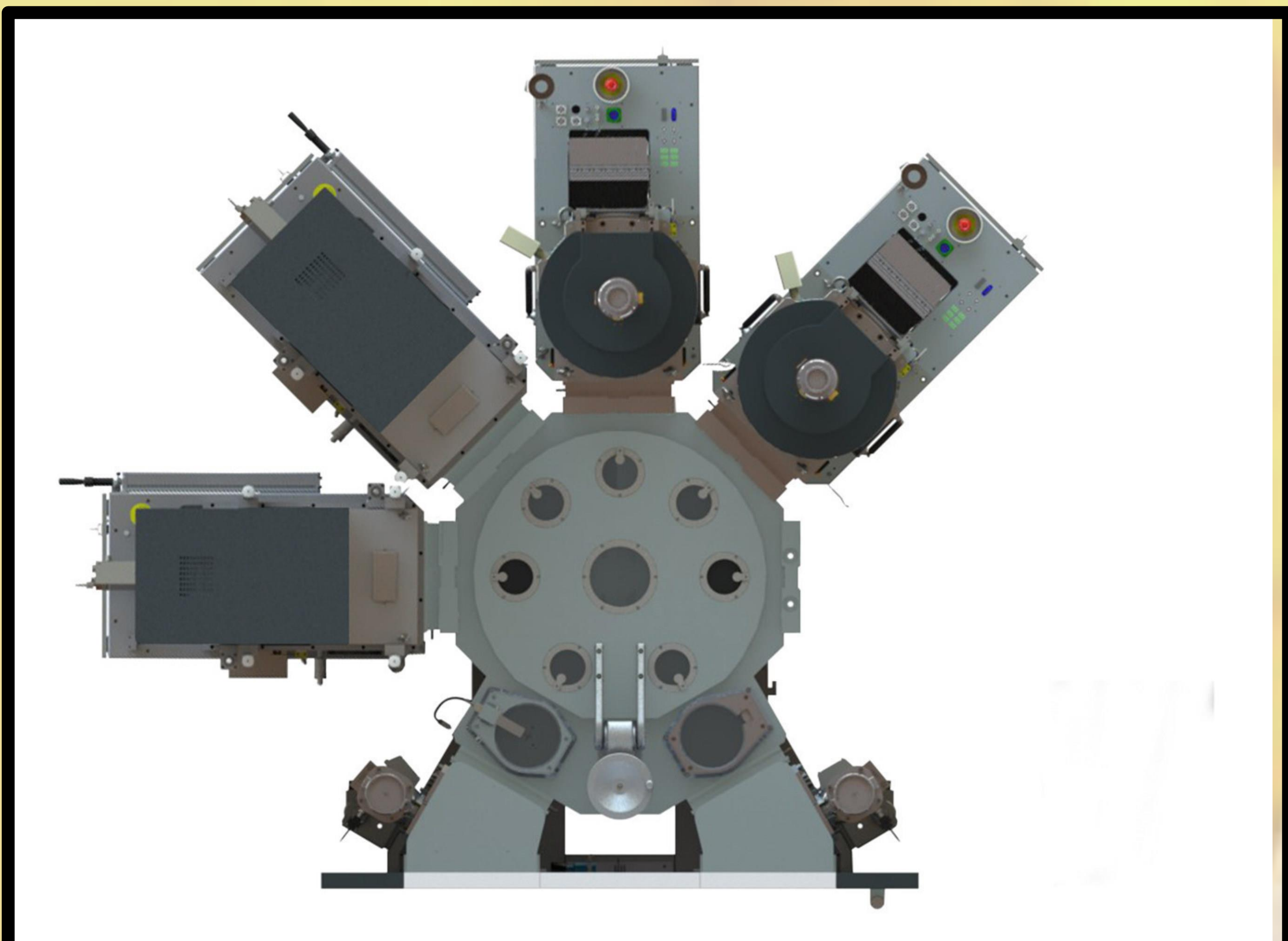


Requalification of the Standard Process for Direct Bonding of Si-Wafers

Projektteam:

- David Schopf
- Lukas Schopf

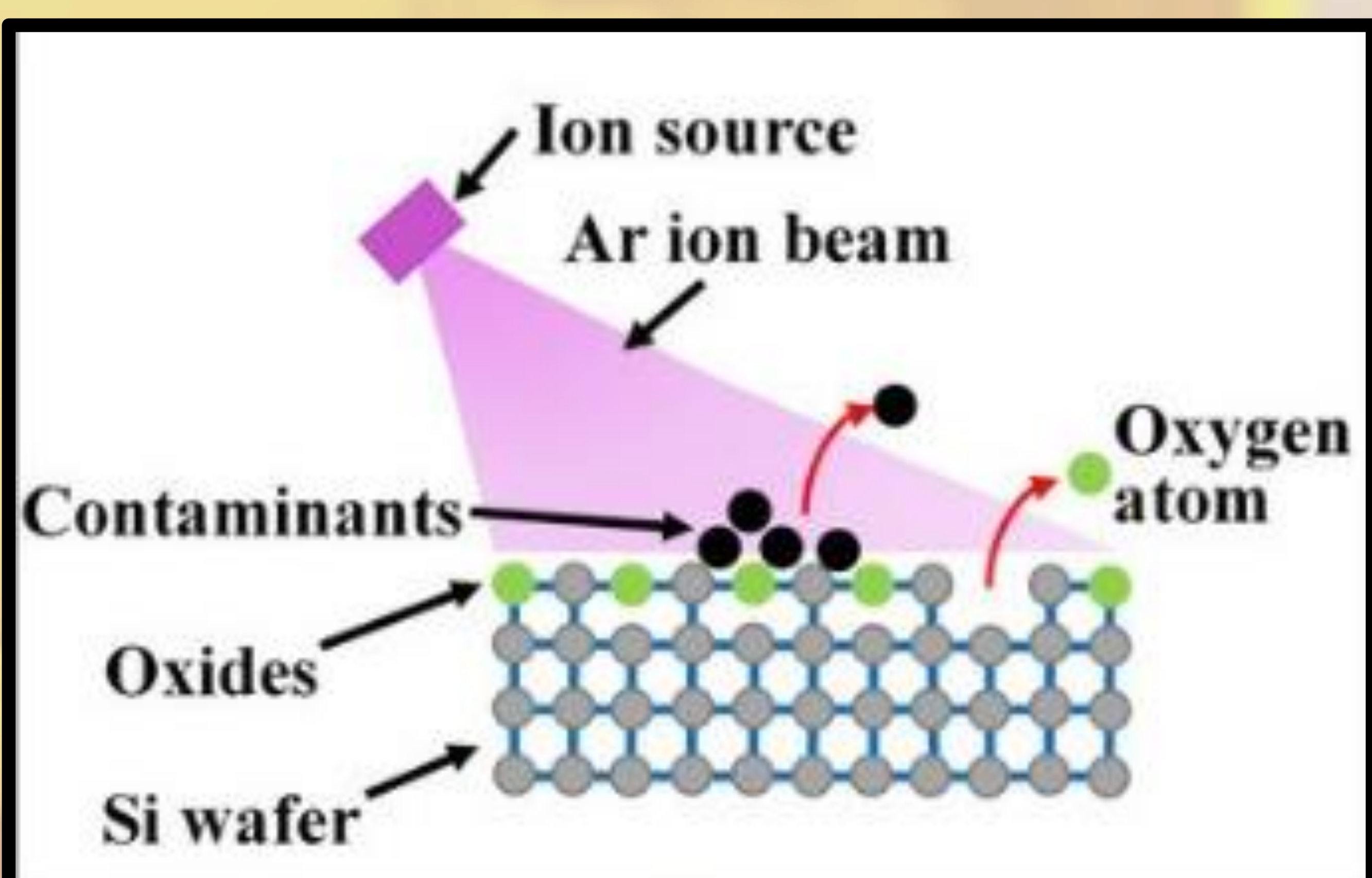


Aufgabenstellung:

- Der Einfluss der fünf wichtigsten Einstellparameter des EVG ComBond auf den Qualifizierungsprozess sollen ermittelt werden
- Der Parameter für die Aktivierungszeit soll dabei genauer untersucht werden

Endergebnis:

- Es stellte sich heraus, dass bei verringerter Aktivierungsdauer, trotzdem eine ausreichend hohe Bondstärke erzielt werden kann



Projektbetreuer:

- Wernicke Tobias – EV Group
- Danner Matthias – EV Group
- Galovsky Ulrike – Andorf Technology School